

证券代码：600330

证券简称：天通股份

## 天通控股股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	现场调研
参与单位名称及人员	交银施罗德基金管理有限公司、国金证券资产管理有限公司、东方红资产管理有限公司、CloudAlpha Capital Management limited (以上排名不分先后)
时间	2026年1月7日13:30
地点	天通(徐州)科技产业基地会议室
公司接待人员	董事长：郑晓彬 压电晶体事业部总经理：徐秋峰 投资者关系管理：姚天恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司发展介绍</b></p> <p>天通控股股份有限公司创办于1984年，拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司将软磁、蓝宝石以及压电晶体等电子材料作为核心业务，将晶体和粉体智能设备作为支撑业务。公司生产基地和业务中心分布在海宁、上海、安徽六安、宁夏银川、江苏徐州等多个区域。</p> <p>天通凯巨科技有限公司是天通股份的全资子公司，聚焦于压电晶体材料研发、生产和制造，涉及长晶、退火极化、晶棒加工、切片、抛光等关键工序，拥有国家级专精特新“小巨人”企业等诸多荣誉，同时拥有22项专利及多项知识产权以及多项国际专利。</p> <p><b>二、问答：</b></p> <p><b>1、贵司的压电晶体业务主要发展历程如何？</b></p> <p>天通压电晶体材料的发展历程是从2016年切入赛道到2025年主导国际标准的突破之路。2016年，公司依托蓝宝石晶体技术积累，联合清华大学攻关压电材料，建成自主生产线。2023年，子公司天通凯巨量产6英寸铌酸锂晶片，适配高速率光模块需求。2024年，攻</p>

克 8 英寸掺铁钽酸锂晶体，填补国内空白，单片晶圆芯片产量提升。2025 年，主导修订国际标准《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》，技术地位获全球认可。

**2、贵司压电晶体业务核心技术涵盖哪些方面？**

公司压电晶体业务核心技术主要涵盖了包括长晶、退火极化、晶棒加工、切片、抛光等关键工序上一系列的工艺技术能力。同时，公司也已掌握了 Bonding+Smart Cut（离子注入法）和 Bonding+Grinding（直接键合法）的异质晶圆键合双工艺路线技术能力。

**3、贵司是否认为压电晶体异质晶圆键合是该材料领域未来的主要技术趋势？**

公司认为在未来很长一段时间内，压电晶体异质晶圆键合将成为该材料量产化应用的主流技术路径。主要原因是该技术方案既能充分利用半导体硅成熟的产业链体系，又能充分利用压电材料优异的光电性能。

**4、能否具体介绍一下压电晶体材料进行异质晶圆键合两种工艺的异同？**

Bonding+Smart Cut（离子注入法）是通过高能离子轰击实现精准掺杂，主要工艺步骤涉及衬底埋氧层制备、离子注入、晶圆键合、退火分离、CMP 抛光等。该工艺路线优点在于均匀性较好，缺点则是由于异质材料的热膨胀系数不同，退火过程中晶格损伤风险较高。Bonding+Grinding（直接键合法）则是通过分子间力实现晶圆无胶结合，主要工艺步骤涉及 Ar 离子轰击、晶圆键合、研磨、化学机械抛光、离子束修复等。该工艺路线优点在于无热应力晶格损伤的风险，但工艺难度相对较高，且均匀性一般。两种工艺公司根据不同的客户和产品需求采用不同的技术方案。

**5、能否具体介绍一下压电晶体材料在 AR 眼镜上的最新应用情况？**

压电晶体材料在 AR 眼镜上的应用正在进行技术验证并表现出了较高的技术优势，主要能解决彩虹纹等行业技术痛点。